

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-042

合盛硅业股份有限公司

关于自愿性披露公司控股子公司碳化硅产品研发成功 并具备量产能力的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波合盛新材料有限公司（以下简称“合盛新材”）于近日成功研发碳化硅半导体材料（简称“新产品”）并具备量产能力，新产品相关情况如下：

一、新产品的研发的基本情况

近年来，随着 5G、新能源等高频、大功率射频及电力电子需求的快速增长，以碳化硅为代表的第三代半导体材料应运而生。

公司通过合盛新材布局第三代半导体产业的研发与制造。合盛新材位于浙江省慈溪市周巷镇，是一家专业从事半导体材料研发和生产的高新技术企业。截至 2022 年底，“宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目”已累计投资 46,208.38 万元。目前，合盛新材 2 万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收，并具备量产能力，6 英寸晶体良率达到 90%，外延片良率达到 95%；产品得到市场的积极反馈，合盛新材的 6 英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户的验证，并顺利开发了日韩、欧美客户。同时，合盛新材 8 英寸衬底研发顺利，已经实现了量产。

二、对公司的影响

公司积极增加工业硅、有机硅、多晶硅&光伏全产业链、碳化硅及芯片产业的规模投入。目前碳化硅衬底产业呈现美国企业全球独大的格局，提高碳化硅衬底材料的国产化率、实现进口替代是我国半导体行业亟需突破的产业瓶颈，公司研发成功后，可以进一步推动碳化硅工艺技术进步，实现进口替代，保障第三代半导体材料的可持续发展。

本次碳化硅产品的研发成功与量产，不会对公司本年度经营业绩产生重大影

响，但预计将会对公司未来经营业绩的提升产生积极影响。

三、风险提示

受宏观经济形势、新能源行业发展情况等因素影响，未来市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性；目前碳化硅产品业务对公司营业收入贡献尚处于上升阶段，对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测；文中涉及的规划目标等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动等可能造成的风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年5月22日